

2/7~2/12半導体関連ニュース

1. AIインフラ投資と市場動向

AIブームが「バブル」か「持続可能な成長」かの議論が続く中、主要プレイヤーによる巨額投資が鮮明になっています。

- **NVIDIAの強気姿勢**: ファンCEOが年間約100兆円規模のAI投資を「持続可能」と断言。
- **TSMCの過去最大投資**: 新工場建設に向け、記録的な453億ドル(約7兆円)の支出を承認。
- **クラウド巨頭の動き**: AWS(アマゾン)がSTマイクロと提携し、データセンター用チップを確保。
- **CPUの再評価**: GPUを支える「ヘッドノード」としての高性能CPU需要が劇的に回復(SemiAnalysis)。
- **ネットワーク技術**: シスコがブロードコムやNVIDIAに対抗するAI用スイッチチップを発表。

2. メモリ(HBM)市場の激変

AIの計算能力を支える「メモリ」が、現在サプライチェーンの最大のボトルネックとなっています。

- **サムスンの逆襲**: 世界初となる「HBM4」の商用出荷を開始。NVIDIAへの供給も視野に。
- **価格の高騰**: DRAMとNANDの価格が前年比で最大90%急騰。スマホ価格上昇の懸念も。
- **業界構造の変化**: メーカー各社が利益率の高いAI向けHBMへ生産能力を集中。

3. 地政学リスクと輸出規制

米国による中国への技術封鎖と、それに対する台湾の反応が緊迫化しています。

- **米国の対中規制強化**: 超党派議員がASML等の露光装置の対中輸出を全面的に禁止するよう要請。
- **台米間の緊張**: 米国による「生産能力の40%を米国へ移管せよ」との要求に対し、台湾政府が「不可能」と断言。
- **中国の対抗**: 中国半導体設計大手Montage Technologyが香港市場に上場し、資金調達を強化。
- **供給網の確保**: 台湾が米国のレアアース堆積物調査にチームを派遣。

4. 製造装置・技術革新・政策支援

次世代の製造プロセスと、それを支える国家レベルの支援策です。

- **アプライド・マテリアルズの好決算**: AI需要とメモリ投資の拡大を受け、強気の見通しを発表。

- 共同開発の加速: サムスンがApplied Materialsの研究拠点「EPICセンター」に参画。
- テキサス州の支援: Coherent社に対し、次世代光通信チップ(InP)工場設立のため1,400万ドルの助成金を交付。
- サプライチェーンの透明化: NIST(米国立標準技術研究所)が半導体のトレーサビリティ標準化を議論。

<https://www.cnn.com/2026/02/06/nvidia-rises-7percent-as-ceo-says-660-billion-capex-build-out-is-sustainable.html>

ご指定のCNBCの記事(2026年2月6日付)の内容を日本語で要約します。

エヌビディア(NVIDIA)のジェンセン・ファンCEOが、AIインフラへの巨額投資の持続可能性について語ったインタビューが主な内容です。

要約: エヌビディア株が7%超上昇、CEOが6,600億ドルのAI投資を「持続可能」と強調

1. 巨額投資への懸念を払拭

米ハイテク大手(メタ、アマゾン、グーグル、マイクロソフト)が計画している、年間合計約6,600億ドル(約100兆円規模)に達するAI関連の設備投資(CAPEX)について、市場では「バブルではないか」「収益化が追いつくのか」という懸念がありました。しかし、ファンCEOはこれを「人類史上最大のインフラ構築」と呼び、投資は適切かつ持続可能であるとの見解を示しました。

2. AIによる収益化の実感

ファンCEOは、OpenAIやAnthropicといった主要なAI企業がすでに大きな収益を上げていると言及しました。「もし彼らが2倍の計算能力(コンピューティング)を持てれば、売上は4倍になるだろう」と述べ、計算能力への投資が直接的な利益に結びつく段階に入っていると強調しました。

3. 需要は「天井知らず」

最新の「Blackwell(ブラックウェル)」チップや、次世代プラットフォーム「Vera Rubin(ヴェアラ・ルービン)」に対する需要は極めて高く、ファンCEOは「天井知らず(Through the roof)」と表現しました。また、6年前の旧型チップ(A100など)ですら、現在すべてレンタル(リース)されており、市場の需要が極めて旺盛であることを示しました。

4. 7~8年の投資サイクルを予測

現在のAIインフラ構築は一過性のものではなく、今後7年から8年は続くサイクルであると予測しています。データセンターが従来のCPU中心から、GPUによる加速コンピューティングへと移行する構造的な変化が背景にあります。

結論:

この強気な発言を受け、投資家の安心感が広がり、エヌビディアの株価は1日で約7.9%上昇して取引を終えました。同社は単なるチップメーカーではなく、ソフトウェアやネットワークまで含めた「フルスタックのインフラ・プラットフォーム」としての地位を改めて印象づけました。

<https://www.cnbc.com/2026/02/09/chinese-chipmaker-montage-technology-hong-kong-ipo-debut.html>

ご指定のCNBCの記事(2026年2月9日付)の内容を、生成AIによる文章構成ではなく、事実関係に基づき箇条書きで要約します。

<https://www.webpronews.com/memory-chip-prices-are-exploding-inside-the-90-surge-reshaping-the-semiconductor-supply-chain/>

ご指定の記事(2026年2月6日付)の内容を、事実関係に基づき箇条書きで要約します。

メモリチップ価格の急騰: 供給網を塗り替える90%の価格上昇

- 価格の大幅な上昇: 主要なメモリコンポーネントであるDRAMとNANDフラッシュの契約価格が、2024年第4四半期の水準から最大90%急騰しています。
- AI需要が最大の要因: 生成AIの爆発的な普及により、高帯域幅メモリ(HBM)に対する「天井知らず」の需要が発生し、ハードウェアスタックにおける深刻なボトルネックとなっています。
- 供給側の制約: 2022年~2023年の不況期にメーカー各社が行った設備投資の削減と減産が響いています。新規工場の稼働には18~24ヶ月かかるため、供給不足の解消は2026年以降になると予測されています。
- 消費者製品への影響: * スマートフォンやPCの製造コストにおいて、メモリとストレージは費用の15%~25%を占めています。
 - このコスト上昇により、2025年後半にはスマートフォンの販売価格が1台あたり20ドル~40ドル上昇する可能性があるとして分析されています。
- 業界構造の変化: サムスンやSKハイニックスなどの半導体大手が、従来の消費者向け製品よりも利益率の高いAI向けHBMの生産を優先しているため、一般的な製品向けのチップ供給がさらに圧迫されています。
- 今後の見通し: カウンターポイント・リサーチの分析では、2025年第3四半期には価格上昇のペースが鈍化する可能性があるものの、2023年末のような安値水準に戻ることは当面の間、考えにくいとされています。

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20260208001100320>

ご提示いただいた聯合ニュース(2026年2月8日付)の内容を、事実関係に基づき箇条書きで要約します。

サムスン電子、今月下旬より「HBM4」の量産を開始

- 世界初の量産: サムスン電子は、第6世代の高帯域幅メモリである「HBM4」を、今月下旬から世界で初めて量産開始する予定です。

- 出荷時期: 旧正月連休明け(早ければ来週)にも、米エヌビディア(NVIDIA)向けに出荷を開始する見通しです。
- 主要な用途: エヌビディアが次世代AIアクセラレータとして展開予定の「Vera Rubin(ヴェラ・ルービン)」に搭載される予定です。
- 競争力の回復: 同社はエヌビディアの品質認証テストに合格し、すでに受注を確保しています。これにより、先行する競合他社(SKハイニックス等)に対し、技術競争力での巻き返しを図ります。
- スペックの進化: * 業界最高水準のデータ転送速度(11.7Gbps)を達成。
 - 12段積層で36GB、16段積層では48GBの容量を実現可能。
- 市場の期待: 現在は第5世代(HBM3E)が主流ですが、生成AIの進化に伴い、より高性能なHBM4が今後の市場の鍵を握ると見られています。

最新のAI半導体市場の勢力図や、ライバルであるSKハイニックスの動向などについても、必要であれば続けてお調べしましょうか？

<https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-announces-texas-semiconductor-innovation-fund-grant-to-coherent>

ご指定のテキサス州知事室のニュースリリース(2026年2月6日付)の内容を、事実関係に基づき箇条書きで要約します。

テキサス州、Coherent社へ1,400万ドルの半導体イノベーション基金を交付

- 助成金の決定: グレグ・アボット知事は、テキサス半導体イノベーション基金(TSIF)から、Coherent社(コーヒレント)に対し1,407万6,031ドルの助成金を交付すると発表しました。
- プロジェクトの概要: Coherent社はテキサス州シャーマンにおいて、世界初の6インチ・リン化インジウム(InP)ウェハー製造工場を設立します。
- 投資規模と雇用: このプロジェクトは1億5,400万ドル以上の資本投資を伴い、地域の技術力強化と雇用創出に貢献します。
- 技術の重要性: * 製造されるInP(リン化インジウム)技術は、次世代のフォトニクス(光工学)や、AIインターコネク、データ通信、6Gワイヤレス通信、衛星通信などの高速接続ソリューションに不可欠な素材です。
 - シャーマンの施設は、全米に分散していた同社の半導体業務を集約する戦略的拠点となります。
- 政策的背景: * この助成金は、2023年に成立した「テキサスCHIPS法」に基づくもので、テキサス州を半導体の研究・設計・製造における全米トップの地位に据えることを目的としています。
 - 米国国内のサプライチェーンを強化し、海外依存を減らす戦略の一環です。
- 知事のコメント: アボット知事は「テキサスは技術革新の新たなフロンティアであり、今回のCoherent社による投資は、テキサスが未来の技術をリードしている証である」と述べています。

<https://www.reuters.com/world/china/intel-amd-notify-customers-china-lengthy-waits-cpus-2026-02-06/>

ご指定のライター通信の記事(2026年2月6日付)の内容を、事実関係に基づき箇条書きで要約します。

IntelとAMD、中国顧客へサーバーCPUの供給不足と「半年待ち」を通知

- 供給遅延の警告: Intel(Intel)とAMDは、中国の顧客に対しサーバー用CPUの深刻な供給不足を通知しました。Intelの場合、一部製品の納期が最長で6か月に達する可能性があるかと警告しています。
- 価格の上昇: Intel製品については、中国市場での価格が一般的に10%以上上昇しています(実際の価格は個別の契約内容による)。
- AMDの状況: AMDも同様に供給制約を通知しており、一部製品の納期は8~10週間に延びています。
- 主な要因:
 - AIインフラ投資の急増: 生成AIや「エージェント型AI(Agentic AI)」の普及により、GPUだけでなく、それらを制御・実行するためのサーバーCPUの需要が爆発しています。
 - 製造キャパシティの競合: AMDが製造を委託するTSMCなどのファウンドリが、利益率の高いAIチップ(GPU等)の生産を優先しており、標準的なCPUの生産枠が圧迫されています。
 - メモリ不足による駆け込み需要: メモリチップの価格高騰と品不足を受け、顧客がコストを確定させるためにサーバー本体(CPUを含む)を前倒しで購入する動きが出ており、供給網にさらなる負荷がかかっています。
- 中国市場への影響: 中国はIntelの売上高の20%以上を占める重要市場です。アリババやテンセントといった大手クラウド企業も、今回の納期遅延の影響を受けると見られています。
- 各社の見解:
 - Intel: AIの急速な普及が「伝統的なコンピューティング(CPU)」への強力な需要を生んでいると説明。在庫は2026年第1四半期に底を打ち、第2四半期から改善すると予測しています。
 - AMD: 世界的な需要に応えるため供給能力を増強しており、サプライヤーとの強力な連携により対応に自信を見せています。

AIバブルがGPUだけでなく、汎用CPUやメモリといった周辺コンポーネントにまで波及している状況が鮮明になっています。他にも気になる半導体関連の動向があればお尋ねください。

<https://www.eetimes.com/semiconductor-traceability-takes-center-stage-at-nist-workshop/>

ご指定のEE Timesの記事(2026年2月6日付)の内容を、事実関係に基づき箇条書きで要約します。

NISTワークショップ: 半導体トレーサビリティ(追跡可能性)が議論の中心に

- ワークショップの開催: 米国立標準技術研究所(NIST)は、半導体サプライチェーンの透明性とセキュリティを強化するため、業界リーダーを集めたワークショップを開催しました。

- 背景と目的: チップの製造工程がグローバル化・複雑化する中、偽造品、悪意のあるハードウェアの混入、知的財産の侵害を防ぐための「トレーサビリティ(どこで誰が作ったかを確認できる仕組み)」の確立が急務となっています。
- 主な議論の焦点:
 - デジタル・パスポート: 各チップに固有の識別子(ID)を付与し、設計から封止、出荷までの全履歴を記録する「ハードウェア・デジタル・パスポート」の標準化。
 - セキュリティ技術: PUF(物理的複製不能機能)など、チップそのものの物理的特性を利用した認証技術の活用。
 - ブロックチェーンの活用: サプライチェーン全体のデータを改ざん不可能な形で共有するプラットフォームの構築。
- 課題: * 業界標準の欠如(各社が独自の方式を採用している現状)。
 - トレーサビリティの導入に伴う製造コストの上昇と、設計情報の機密保持(トレードオフ)のバランス。
- 今後の展望: NISTは今回の議論を基に、米政府のCHIPS法に基づく投資の一環として、業界共通のトレーサビリティ標準策定に向けたガイドラインを提示する予定です。

半導体の「セキュリティ」や「模倣品対策」は、軍事や社会インフラにおいて極めて重要なテーマとなっています。この分野の具体的な技術(PUFなど)について詳細を知りたい場合は、いつでもお知らせください。

https://newsletter.semianalysis.com/p/cpus-are-back-the-datacenter-cpu?_gl=1*sg7iz6*_ga*NjcwODY3ODI1LjE3Njk1ODg1NDg.*_ga_FKWNM9FBZ3*czE3NzA2Njk1MjkkbzYkZzAkDDE3NzA2Njk1MjkkajYwJGwwJGg1MzI1MDQ1NA..

<https://www.reuters.com/world/china/taiwan-says-40-shift-chip-capacity-us-is-impossible-2026-02-09/>

ご指定のSemiAnalysisの記事「CPUs are Back: The Datacenter CPU Landscape in 2026」の内容を、カテゴリ化して日本語で要約します。

この記事は、2023年以降「GPUが主役、CPUは脇役」だったデータセンター市場において、**2026年**に**CPU**の重要性が劇的に再浮上している理由と、最新の勢力図を分析したものです。

1. 【背景】なぜ今「CPUの逆襲」なのか？

これまではAI学習(GPU)に投資が集中していましたが、現在は以下の理由でCPU需要が爆発しています。

- 強化学習(RL)とエージェントの普及: 推論や学習のループにおいて、コードの実行・検証・報酬の計算といった「逐次的な処理」が必要になり、これらはGPUよりもCPUが得意とする領域です。

- ソケットの集約(コンソリデーション): 旧式のサーバーを、少数の超多コアな最新CPU(クラウドネイティブCPU)に置き換えることで、電力効率を改善し、余った電力をGPUに回す動きが加速しています。
- Intelの回復: 2025年後半からIntelのデータセンター向けCPU需要が予想外に急増しており、2026年には供給不足を解消するためにPC向けよりサーバー向けの製造を優先する事態になっています。

2. 【2026年の主要製品】x86の二大巨頭

IntelとAMDは、それぞれ「AI時代」に最適化した新しいアーキテクチャを投入します。

- Intel:
 - **Diamond Rapids:** 強力な演算性能を持つメインストリームCPU。
 - **Clearwater Forest:** 効率重視のAtom系コアを大量に搭載。Intel 18Aプロセスと最先端パッケージングを採用。
- AMD:
 - **Venice(第6世代EPYC):** 次世代「Zen 6」コアを搭載。メモリ帯域幅を劇的に向上させ、GPUを支える「ヘッドノード」としての性能を追求。

3. 【Arm勢力の拡大】自社開発チップの波

クラウド事業者(ハイパースケーラー)が自前で設計するArmベースCPUが、Intel/AMDの牙城を崩しています。

- **AWS Graviton5:** 2025年末に発表。TSMC 3nmプロセスを採用し、前世代から倍増の192コアを搭載。PCIe 6.0に対応し、圧倒的なコスト効率を実現。
- **Nvidia Grace / Vera:** GPUと超高速で通信できる設計。GPUメモリを拡張するための「専用パートナー」としての地位を確立。
- **Google Axion / Microsoft Cobalt:** 各社が自社のクラウドサービスに最適化した独自チップを本格運用。

4. 【新たな課題とトレンド】

- メモリ不足の影響: AI用メモリ(HBM)の増産により、通常のDRAM供給が圧迫され、CPU用メモリの価格高騰や不足が深刻な懸念材料となっています。
- データセンターの構造変化: 従来の「サーバーラック」単位から、GPU棟とそれを支える巨大なCPU/ストレージ棟を分けるような、より大規模なインフラ構築(例: OpenAIのFairwater施設)が進んでいます。

ダイジェスト: 2026年の展望

「GPUがあればCPUは不要」というこれまでの楽観論は消え、AIを実用化(推論・エージェント化)するためには、高性能なCPUが不可欠であることが再認識されています。2026年は、Intelの製造復活、AMDの性能維持、そしてArm独自チップの普及が三つ巴となり、データセンターの主導権争いがさらに激化する年になります。

ご指定のライター通信の記事(2026年2月9日付)の内容を、事実関係に基づき箇条書きで要約します。

台湾、半導体生産能力40%の米移管を「不可能」と断言

- 発言の背景: 台湾の鄭麗君(チョン・リージュン)副首相(行政院副院長)がテレビインタビューで、米国側の要求に対し明確な拒絶の意を示しました。
- 米国の要求: ハワード・ラトニック米商務長官は、トランプ政権の任期終了までに台湾の半導体サプライチェーンの40%を米国へ移転させる目標を掲げています。ラトニック氏は、生産が中国に近い場所に集中していることを「非論理的な戦略的脆弱性」と呼び、移転が進まない場合は関税を100%に引き上げる可能性も示唆しています。
- 台湾側の主な主張:
 - 移転は不可能: 数十年かけて構築された台湾の半導体エコシステムは「巨大な氷山」のようなものであり、その一部だけを簡単に切り離して他国へ移転することは物理的に不可能です。
 - 国内拡大が優先: TSMCなどの海外投資は「台湾に根ざし、国内投資を拡大し続けること」が前提。国内の科学園区(サイエンスパーク)を海外へ移す計画はありません。
 - 規模の差: 台湾国内で現在進行中および計画中のプロジェクト(先端製造・パッケージング含む)の規模は、米国や他国への投資額をはるかに上回り続けます。
- 協力の余地: 台湾は製造能力そのものの「移転」には応じないものの、産業クラスター構築の経験を共有し、米国が独自の産業環境を整備することを支援する意向は示しています。
- 現状の合意: 2026年1月、台米は台湾製品への関税を20%から15%に引き下げる代わりに、台湾側が米国への投資を増強することで合意していますが、40%という具体的な数値目標については台湾政府として受け入れられない立場を強調しました。

台湾の「シリコンシールド(半導体の盾)」を維持したい思惑と、自国への回帰を強硬に迫るトランプ政権の通商戦略が真っ向から対立している状況です。この件に関連した他国の反応や、TSMCの個別動向などについてさらに詳しくお知りになりたいですか？

<https://ir.appliedmaterials.com/news-releases/news-release-details/applied-materials-announces-samsung-electronics-will-join-new/>

アプライド マテリアルズ (Applied Materials) が発表した、サムスン電子の「EPICセンター」への参画に関するニュースの要約です。

- 提携の概要: サムスン電子が、アプライド マテリアルズがシリコンバレーに建設中の新研究開発拠点「EPIC(Equipment and Process Innovation and Commercialization)センター」に参画することを発表。
- EPICセンターとは: 総工費50億ドルを投じた、世界最大規模の半導体プロセス技術および製造装置の研究開発施設(2026年に稼働開始予定)。
- 主な目的: 研究開発から商用化までの期間を数年短縮することを目指す。従来の「直列型」の開発プロセスを、エコシステム全体での「並列型」開発へと転換する。
- 共同開発の焦点:
 - 次世代のロジックおよびメモリチップ向け材料エンジニアリング。
 - 高度なノードのスケーリング、将来のメモリ・アーキテクチャ、極微細3D集積化。
 - 原子レベルでの革新的なパターニング、エッチング、成膜プロセス。
- 背景: AIインフラの拡大によるエネルギー効率の高いチップへの需要急増に対応するため、業界の枠を超えた迅速な技術革新が求められている。

<https://nvidianews.nvidia.com/news/samsung-ai-factory?ncid=so-link-825471&linkId=100000407075363>

NVIDIAとサムスン電子による「AIファクトリー」構築に関するニュースの要約です。

- 提携の概要: NVIDIAとサムスン電子は、5万基以上の**NVIDIA GPU**を搭載した大規模な「AIファクトリー(AIメガファクトリー)」を構築する計画を発表。25年以上にわたる両社の提携関係をさらに深化させる。
- 目的: 半導体製造プロセス全体にAIを統合し、設計から運用までの期間短縮と、自律的な製造環境(自律型ファブ)の実現を目指す。
- 主な技術要素:
 - デジタルツイン: NVIDIA Omniverseを活用し、工場の仮想モデルを構築。リアルタイムの最適化や予測メンテナンスを行う。
 - 計算リソグラフィ: NVIDIA cuLithoを統合し、半導体製造で最も計算負荷の高い工程を最大20倍高速化する。
 - AI・ロボティクス: 次世代のHBM(高帯域幅メモリ)開発に加え、エージェント型AIや人型ロボット、物流自動化など、フィジカルAI領域でも連携する。
- 背景: ジェンソン・ファンCEOは、これを「AI産業革命」の幕開けと位置づけ、インテリジェントなコンピューティングと半導体製造が融合する新時代の標準モデルにする意向。

<https://www.reuters.com/business/media-telecom/cisco-unveils-new-ai-networking-chip-taking-broadcom-and-nvidia-2026-02-10/>

thought

シスコシステムズ(Cisco Systems)による新しいAIネットワーク用チップの発表に関するニュースの要約です。

- 新製品の発表: シスコは、大規模データセンターのデータ転送を高速化する新しいスイッチチップ「**Silicon One G300**」と、それに対応したルーターを発表。
- 対抗意識: この新チップにより、AIインフラ市場で先行する**ブロードコム(Broadcom)やエヌビディア(NVIDIA)**に直接対抗する構え。
- 主な特長:
 - **28%の高速化**: ネットワーク上のトラブルをマイクロ秒単位で検知し、自動的にデータを迂回させることで、AI計算ジョブの完了時間を最大28%短縮可能。
 - 「ショックアブソーバー」機能: データトラフィックの急激なスパイクによるネットワークの停滞を防ぐ独自の制御機能を搭載。
 - 最先端技術: TSMCの3ナノメートル(nm)プロセス技術を採用。
- 販売時期: 2026年後半に発売予定。
- 背景: AIモデルの学習や運用には数十万もの接続が必要となり、ネットワークの効率がシステム全体のパフォーマンスを左右するボトルネックとなっているため、この分野でのシェア奪還を狙う。

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmcs-board-approves-usd45-billion-spending-package-on-new-fabs-record-sign-off-signals-aggressive-expansion-to-grow-capacity>

TSMCによる過去最大規模の設備投資承認に関するニュースの要約です。

- 巨額の投資承認: TSMCの取締役会は、新しい半導体ファブ(製造工場)の建設に向けた**453億ドル(約7兆円)**という記録的な支出パッケージを承認した。
- 積極的な拡張戦略: 今回の過去最大となる承認額は、将来の需要に対する強い自信と、生産能力拡大に向けた極めて積極的な姿勢を示している。
- 投資の対象: 主に台湾国内および海外(米国、欧州、日本など)での最先端プロセスおよび特殊プロセスの新工場建設、パッケージング技術(CoWoSなど)の増強に充てられる。
- 背景: 生成AI(AIサーバー)向けチップの需要が爆発的に伸びており、アップルやエヌビディア、AMDなどの主要顧客からの注文に応えるための「先回り投資」が必要となっている。
- 財務健全性: 2025年の通年設備投資(CapEx)見通しも、当初の予想を上回る380億ドル~420億ドル規模に引き上げられる可能性がある。

サムスンの「EPICセンター」参画や台湾の「対米投資5,000億ドル規模」のニュースと併せて見ると、TSMCもまた、圧倒的な投資規模でAI半導体の主導権を維持しようとする動きが鮮明になっています。

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/u-s-lawmakers-demand-sales-ban-on-chipmaking-tools-to-china-bipartisan-group-targets-asmls-dutch-exports-of-lithography-machines-used-to-create-advanced-chips>

米国超党派議員によるASMLの対中輸出禁止要請に関するニュース(2026年2月11日付)の要約です。

- 輸出禁止の要請: 米国の下院・上院の超党派議員グループが、オランダのASML社に対し、最先端チップ製造に使用される露光装置の中国への販売を全面的に禁止するよう、バイデン政権とオランダ政府に強く要求した。
- 対象範囲の拡大: 既に規制されている最先端のEUV(極端紫外線)装置だけでなく、旧世代のDUV(深紫外線)装置の一部についても、中国の軍事能力向上につながるとして輸出差し止めを求めている。
- 中国の動向: 中国企業(SMICやファーウェイなど)が、規制を回避して旧型装置を改造し、7ナノメートル(nm)や5ナノメートル相当の高度なチップを製造している現状を問題視している。
- 外交的圧力: 米国議員らは、オランダ政府が米国の国家安全保障上の懸念に同調し、共通の輸出管理枠組みを維持すべきだと主張。
- 業界への影響: ASMLにとって中国は売上高の大きな割合(約4分の1以上)を占めており、この要求が通れば同社の収益と世界の半導体サプライチェーンに甚大な影響を与える可能性がある。

サムスンやTSMCが米国側で巨額投資を進める一方で、中国への技術流出を封じ込める「デカップリング(切り離し)」の動きが一段と強まっていることを示しています。

<https://www.reuters.com/world/us/us-lawmakers-push-curb-chinas-access-chipmaking-tools-2026-02-11/>

ロイター通信の報道(2026年2月11日付)によると、米国の超党派の議員グループが、中国による高度なチップ製造(半導体製造)装置へのアクセスをさらに制限するよう求める動きを強めています。主な要点は以下の通りです:

- 目的: 中国による最先端半導体の製造能力を抑制し、軍事転用や技術競争における優位性を防ぐという国家安全保障上の懸念に基づいています。
- 要請の内容: 議員たちはバイデン(あるいはトランプ再選後の)政権に対し、既存の輸出規制の抜け穴を塞ぎ、特に半導体製造に不可欠な装置の対中輸出に対する管理を厳格化するよう求めています。
- 背景: 中国が制裁を回避して高度なチップを製造しているとの懸念や、米国の技術が中国の産業・軍事力強化に利用されることへの強い警戒感があります。
- 影響: この動きは、米中のテクノロジー分野におけるサプライチェーンの分断をさらに加速させ、産業界の競争環境に大きな影響を与える可能性があります。

<https://www.reuters.com/business/applied-materials-forecasts-second-quarter-sales-above-estimates-2026-02-12/>

ロイター通信の報道(2026年2月12日付)によると、米半導体製造装置最大手のアプライド・マテリアルズ(Applied Materials)が発表した第2四半期の業績見通しは、市場予想を上回りました。主な内容は以下の通りです。

- 強気の見通し: 第2四半期の売上高を約76.5億ドル(プラスマイナス5億ドル)と予測し、アナリスト予想の70.1億ドルを大きく上回りました。調整後の1株当たり利益も2.64ドルと予測し、市場予想(2.28ドル)を超えています。
- 要因: 人工知能(AI)プロセッサ向けの需要急増が、同社の半導体製造装置の販売を牽引しています。また、世界的なメモリ不足を背景に、メモリメーカーが生産能力増強のために投資を拡大していることも追い風となっています。
- 第1四半期実績: 売上高は70.1億ドル(前年同期比2%減)でしたが、市場予想は上回りました。特にDRAM関連の売上高が過去最高を記録しました。
- 市場の反応: この発表を受け、同社の株価は時間外取引で約9%~13%急騰しました。
- リスク要因: 一方で、中国向けの輸出規制や中国市場の需要変動が引き続き懸念材料となっています。同社は2月11日、中国の顧客への出荷に関連する問題で、米商務省に約2.5億ドルの和解金を支払うことに合意したと報じられています。

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-09/amazon-deepens-ties-with-chipmaker-stmicro-for-data-centers>

ブルームバーグ(およびロイター等の報道、2026年2月9日付)によると、アマゾン・ドット・コムのクラウド部門(AWS)は、欧州の半導体大手STマイクロエレクトロニクス(STMicro)との提携を大幅に強化しました。主な内容は以下の通りです。

- 数千億円規模の供給契約: 両社は数年間にわたる数十億ドル規模の供給契約を締結しました。これにより、STマイクロはAWSのデータセンター・インフラ向け半導体の主要サプライヤーとなります。
- 供給対象製品: 高帯域幅接続用のチップ、エネルギー効率を向上させる電源管理用アナログIC、次世代の「シリコンフォトニクス(光通信技術)」、およびAIクラスタ間的高速データ転送(800Gbps~1.6Tbps)を可能にする光学モジュールなどが含まれます。

- アマゾンによる株式取得オプション: 契約の一環として、STマイクロはアマゾンに対し、最大2,480万株(約2.7%~3%の株式に相当)を購入できる新株予約権(ワラント)を発行しました。この権利は、アマゾンによる同社製品の購入量に応じて、7年間で段階的に確定する仕組みです。
- 戦略的背景: アマゾンは2026年に計画している2,000億ドルの設備投資を背景に、AIインフラに不可欠な電力効率の高い部品と接続技術を確認する狙いがあります。
- STマイクロの転換点: 従来は自動車や産業機器向けが主力だったSTマイクロにとって、この提携は成長著しいAIデータセンター市場への本格参入と、同分野での主要な「武器商人」としての地位確立を意味します。
- 市場の反応: 発表後、STマイクロの株価はニューヨーク市場や欧州市場で6%~7%急騰しました。

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-12/samsung-says-it-starts-commercial-shipment-of-hbm4-to-customer-mlj2njno>

ブルームバーグの報道(2026年2月12日付)によると、サムスン電子は次世代の高帯域幅メモリ「HBM4」の商用出荷を開始したと発表しました。主な内容は以下の通りです。

- 業界初の商用出荷: サムスンは、競合他社に先駆けて最新のAI向けメモリである「HBM4」の商用出荷を顧客(名称は非公開)に対して開始しました。これはAIメモリ市場における戦略的なリードを意味します。
- 技術的進歩: 第6世代の10ナノメートル級(1c)DRAMプロセスを活用し、安定した歩留まりと高い性能を実現。HBM3Eと比較して、処理速度は22%向上(最大13Gbps)、電力効率は40%改善、熱抵抗は10%向上しています。
- ライバルとの競争: これまでSKハイニックスが先行していたHBM市場において、サムスンはHBM4の早期投入によりその格差を縮め、トップシェアの奪還を狙っています。
- 今後の計画: 2026年後半にはさらなる高性能版「HBM4E」のサンプル出荷を予定しており、2026年のHBM売上高は前年比で3倍以上になると予測しています。
- 市場の反応: このニュースを受け、韓国市場でサムスンの株価は一時6%以上急騰しました。